

Hypersonic

瀚軒股份有限公司

Hypersonic Inc.

興櫃掛牌前法人說明會

半導體先進封裝與測試整合解決方案領導者

2026年6月25日

免責說明

Disclaimer

本資料可能包含對於未來展望之表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知、未知風險或不確定性的影響，因此實際結果將可能不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務更新對未來展望的表述。

大綱

Agenda

01

● 公司簡介

02

● 公司願景 / 產業定位 / 全球布局

03

● 業務介紹 / 核心競爭優勢

04

● 財務資訊

05

● 總結

01

公司簡介

Company Profile

公司概況

Company Overview



成立時間： 1987/7



實收資本額： 新台幣2.4億元



證券代號： 7894



員工人數： 154人



營業據點： 營運總部位於中壢
(台灣和中國設有多個經銷據點及一個研發製造中心)



市場定位： 半導體與電子領域產品之代理銷售與技術服務，專精於IC封裝、IC測試、微機電、光電及自動化設備並提供研發、技術支援與製程整合等整體增值化服務。

董事會	姓名	主要學經歷
董事長	林斯穎	<ul style="list-style-type: none"> 陽明交通大學電信工程系 恆軒投資(股)公司監察人
董事	陳文冠	<ul style="list-style-type: none"> 陽明交通大學資訊工程系 翌聯實業(股)公司董事 冠兆投資(股)公司董事長
董事	林逸羣	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大學大氣科學系 美國曼菲斯大學商學院碩士
董事	張添昌	<ul style="list-style-type: none"> 中央大學電機所 聯發科技(股)副總 智微科技(股)顧問 大芯科技(股)公司總經理 大云永續科技(股)公司資深合夥

董事會	姓名	主要學經歷
獨立董事	劉慧儀	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大學商學系、會計師資格 台亞風能(股)公司營運管理總監 亞洲新能源(開曼)(股)公司營運管理總監 證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員
獨立董事	洪欣儒	<ul style="list-style-type: none"> 美國紐約大學法律系LLM 台灣律師執照及美國紐約州律師資格 緯鴻眾理法律事務所主持律師 理律法律事務所資深律師
獨立董事	胡瑞卿	<ul style="list-style-type: none"> 交通大學EMBA 美國史丹佛大學運籌管理系碩士 潘杰(股)公司董事長兼總經理 美商英特爾Intel Capital總監 漢民科技(股)公司新事業發展副總經理/策略投資副總經理 醫智亮加速器(股)公司董事兼執行長

發展里程碑

Milestones

1987年

正式成立
代理半導體設備與材料

1999年

更名為
瀚軒股份有限公司

2002年

開發IC分選機/記憶體高速印刷機
跨入自製產品

2004年

設立瀚發貿易上海
拓展兩岸服務

2014年

通過ISO9001:2015
品質管理系統認證

2018年

切入車用功率元件測試市場

2021年

SiC功率模組測試機
獲工研院採用

2023年

水滴角自動化量測設備
開發成功並取得專利

2024年

自製產品導入全球手機
領導品牌供應鏈
AI與HPC市場

2025年

於12月15日經核准補辦公開
發行股票代號7894
正式邁向資本市場

2026年

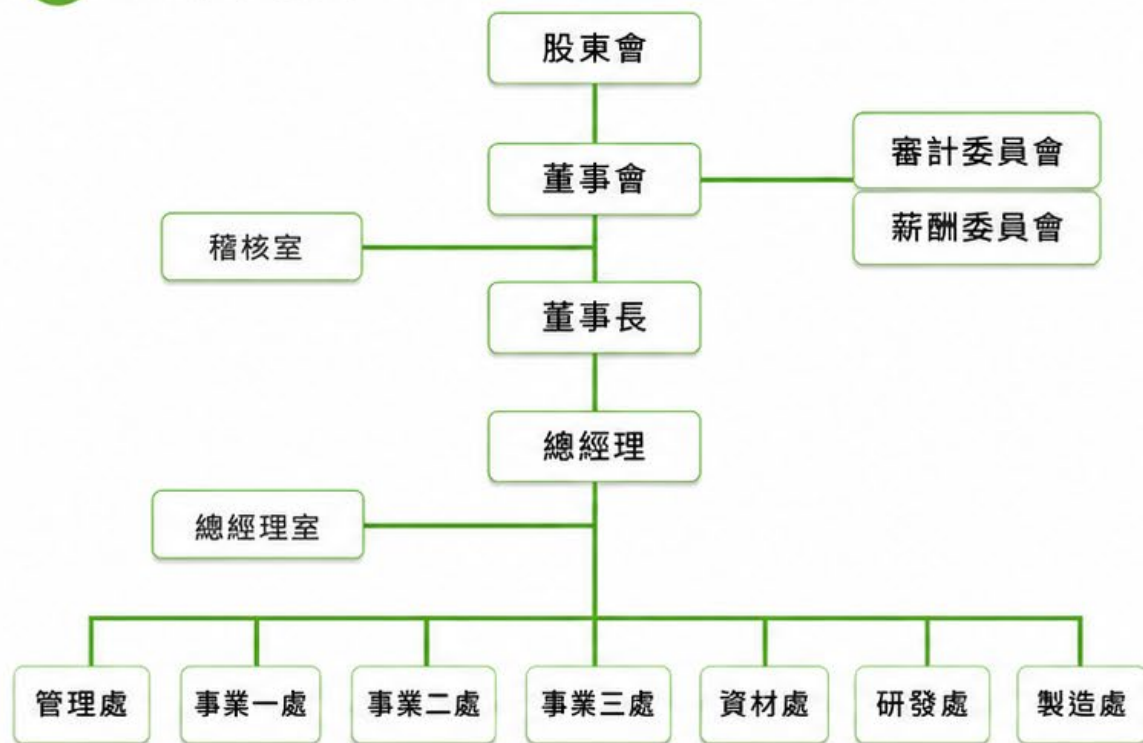
正式興櫃掛牌

組織架構與經營團隊

Management Team



組織架構圖



經營團隊

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	林斯穎	<ul style="list-style-type: none"> 陽明交通大學電信工程系 恆軒投資(股)公司監察人
總經理	陳文冠	<ul style="list-style-type: none"> 陽明交通大學資訊工程系 翌驊實業(股)公司董事 冠兆投資(股)公司董事長
資深副總	林逸羣	<ul style="list-style-type: none"> 台灣大學大氣科學系 美國曼菲斯大學商學院碩士 瀚軒(股)公司研發製造處資深副總
副總	張睿政	<ul style="list-style-type: none"> 東海大學物理系 瀚軒(股)公司業務副總
副總	邱哲儀	<ul style="list-style-type: none"> 嘉義大學 農經系 瀚軒(股)公司業務副總

職稱	姓名	主要學經歷
副總	桑友樂	<ul style="list-style-type: none"> 成功大學工程科學所碩士 瀚軒(股)公司資材處副總
協理	江美雲	<ul style="list-style-type: none"> 嶺東商業專科學校企管系 瀚軒(股)公司管理處協理
協理	李倩倩	<ul style="list-style-type: none"> 世新大學新聞系 瀚軒(股)公司稽核室協理
協理	陳俊良	<ul style="list-style-type: none"> 逢甲大學自動工程學系 瀚軒(股)公司事業處技術售服協理
總經理特助暨發言人	陳國烘	<ul style="list-style-type: none"> 中原大學土木工程學系碩士 瀚發貿易(上海)資深副總

公司願景

Vision



願景

成為全球半導體產業中「先進封裝與測試整合解決方案」的領導供應商

品質政策

Policy



Professional & Enthusiasm

專業熱忱



Value Commitment

重視承諾



Transparency

行事透明



Win-Win

共創雙贏

產業定位

Industry Positioning



全球業務範圍

Global Footprint



台灣核心

- 中壢總公司
- 新竹辦公室
- 高雄辦公室
- 南科研發製造中心



佈局中國

- 蘇州
- 東莞
- 成都
- 天津
- 合肥
- 西安
- 上海



國際拓展

配合客戶供應鏈分散化，
積極佈局東南亞及國際市場



03

業務介紹 / 核心競爭優勢

Business Segments / Core Capabilities

業務範疇

Business Scope

國際品牌代理



自主研發製造

增值協同效益

主要代理產品 - 封裝

Main Products- Packaging



產品：全自動點膠系統

應用：應用於
FCBGA/FCCSP及
高階封裝CoWoS
Underfill點膠及
SiP點膠



產品：晶圓切割保護液

應用：晶圓切割時使用
之介面活性劑，
避免矽粉殘留於
晶圓表面



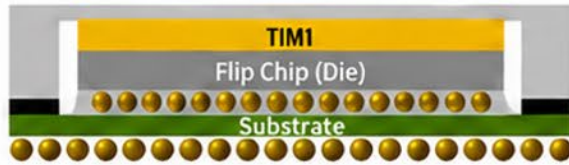
產品：電漿清洗設備

應用：Underfill &
Molding前之基
板及晶圓表面清
洗。



產品：X-ray 檢測設備

應用：應用於HBM及
一般IC需透視檢
視內部缺陷



產品：TIM膠

應用：使用於FCBGA
散熱片黏著及導熱



產品：液態環氧樹脂

應用：主要技術應用於
半導體先進封裝
(InFO/CoWoS)
及HBM



產品：助焊劑清洗液

應用：應用於先進封
裝和SiP助焊劑
清洗

主要代理產品 – 測試與HVDC

Main Products- Testing and HVDC



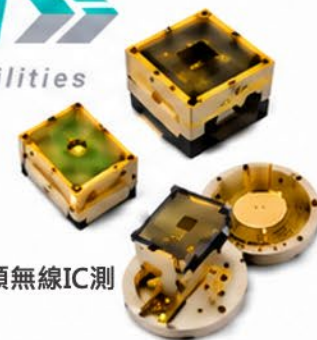
產品 飛針機、電源模組轉換器測試機、
微機電感測器測試機

應用 • AI伺服器板級測試
• 伺服器/車用電源管理模組測試
• 手機/無人機/機器人感測器單元
測試/HVDC



產品 高功率burn-in oven

應用 AI/ 車用/ 高功率元件burn-in



產品 測試插座(Socket)

應用 AI/ HVDC/ 車用/ 高頻無線IC測
試介面



產品 甲酸爐、
IC貼片機、
電源模組
測試分選機

應用 電源模組
封裝及測試
自動化相關設備



產品 IC測試三溫 (常溫、高溫、
低溫) 分選機

應用 • 大功率三溫IC分選
• AI及各式三溫環境
IC測試需求分選



產品 高低溫衝擊機·熱流儀

應用 晶片特性分析·
高低溫變溫測試/篩選

⊕ 測試、burn-in、插座與三溫分選，支援 AI HVDC/高速邏輯/高功率元件測試需求

自製產品

In-house Products

重力式IC分選設備

應用

- 類比IC Final Test
- 高電壓 IC Isolation Test



晶粒挑檢設備

應用

- 把好的晶粒從測試過已切割的晶圓挑檢出來
- LCD Driver IC/ Logic IC



全自動 DDR 印膠設備

應用

- 將 B-stage 膠均勻、準確、快速、印刷在 DDR 基板上
- UPH 業界第一
- 記憶體(DDR1~5)



水滴角量測設備

應用

- 晶圓 / 基板 / IC 表面潔淨度檢測
- 提升後製程 (Wirebond / Diebond / Underfill) 良率穩定性



智慧化分盤設備

應用

- 利用光學辨識與智慧化分選，避免人工作業可能產生的混料風險



散熱蓋貼片設備

應用

- 應用於半導體先進封裝 CoWoS 及 FCBGA / FCCSP

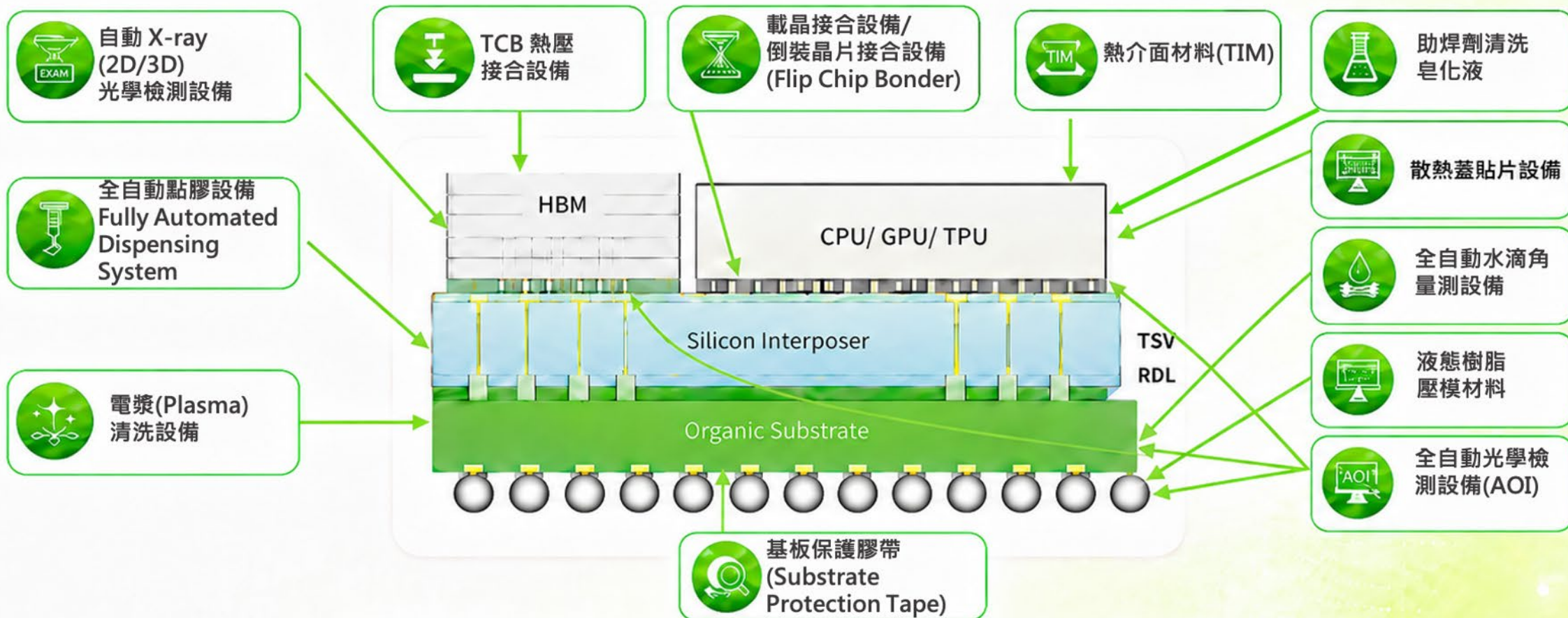


聚焦自製設備開發，支援先進封裝、測試與智慧自動化應用



先進封裝應用佈局

CoWoS Application in AI / HPC Packaging



應用領域：AI / HPC、HBM

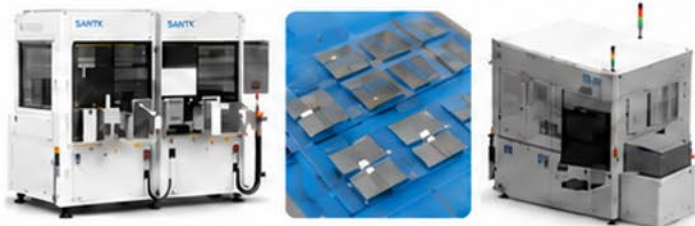


AI Server HVDC高功率模組-應用佈局

AI Server HVDC High Power Module- Industry Layout

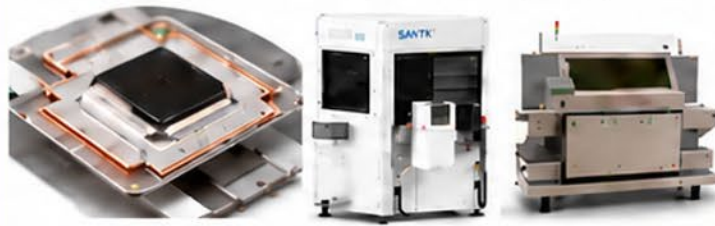
基板與晶圓準備 (Substrate & Die Prep)

- 核心目標：核心材料與基板製作
- 技術與流程：使用 Si3N4 AMB 基板，雷射切割，並以 AOI 進行缺陷檢測
- 使用設備：SMTK DIE 分選機，SMTK 貼片機



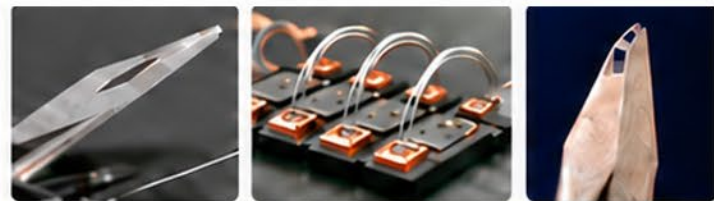
晶片黏結 / 燒結 (Die Attach / Sintering)

- 核心目標：SiC 與基板接合
- 技術與流程：以銀或銅燒結技術接合，需高溫高壓，氣孔率 < 1%
- 使用設備：SMTK 燒結爐，SMTK 甲酸迴焊爐



電氣連接 / 打線 (Interconnect)

- 核心目標：模組內互連技術
- 技術與流程：以 Copper Clip 與超音波打線建立電氣連接，並做拉力 / 剪切測試
- 使用工具：Wedge tool



模組封裝 / 成型 (Molding)

- 核心目標：模組保護與密封
- 技術與流程：以環氧樹脂進行灌封，高壓電弧保護
- 使用材料：GracoRoberts 灌封膠



底板整合 / 散熱 (Baseplate Assembly)

- 核心目標：終端散熱與組裝
- 技術與流程：安裝 Pin-fin baseplate，塗佈TIM，並完成氣密 / 漏水測試
- 使用材料：Momentive 散熱膠



後段與終端測試 (Testing & Quality)

- 核心目標：完整功能與可靠度驗證
- 技術與流程：進行動靜態參數測量、Hi-Pot 測試、老化測試、X-ray探傷
- 使用設備：SPEA 功率測試機，SMTK 功率模組分選機



核心競爭優勢

Core Competitive Advantages of Agency & In-house Solutions



合作客戶

Key Customers / Partners

Wafer Foundry (晶圓代工)



IC Design house (IC 設計公司)



Advanced IC Packaging & Testing (先進IC封裝與測試)



Traditional IC Packaging & Testing (傳統封裝與測試)



MEMS, Sensors and Optical (微電機系統/感測器與光學)



OPTO Automotive Clean Energy Industry (光電汽車與潔淨能源)



System Integrator/ EMS/ ODM (系統整合與電子代工)



Aerospace Industry (航空航太產業)



未來發展策略與展望

Future Development Strategy & Outlook

未來發展策略與展望

Future Development Strategy & Outlook



透過高附加價值設備的技術佈局，持續優化獲利結構並擴大市場市佔。

自製產品未來發展策略與展望

In-house Product Future Development Strategy & Outlook

發展方向



- 聚焦先進封裝CoWoS/FOPLP/CPO製程
 - 持續既有設備(水滴角量測及散熱蓋貼片)的優化及升級,增強客戶黏著度
 - 與客戶緊密合作,發掘新的切入點,開發新的應用設備



- 放眼AI伺服器相關客製化設備
 - 已導入AI 伺服器客戶(ICT針床視覺檢測及探針彈力檢測)。
 - 持續強化並提供AI 伺服器客戶的客製化需求



- AI智能轉型
 - 導入AI工具優化生產流程
 - 將 AI演算法植入設備,提升檢測與生產效率

策略佈局



- 不斷提升研發能量
 - 由外部招募有經驗專業領域人員(例如:視覺檢測,特殊程式控制)
 - 現有內部研發人員培訓



- 專利智財保護
 - 深化核心專利與智財權,構築完善競爭壁壘



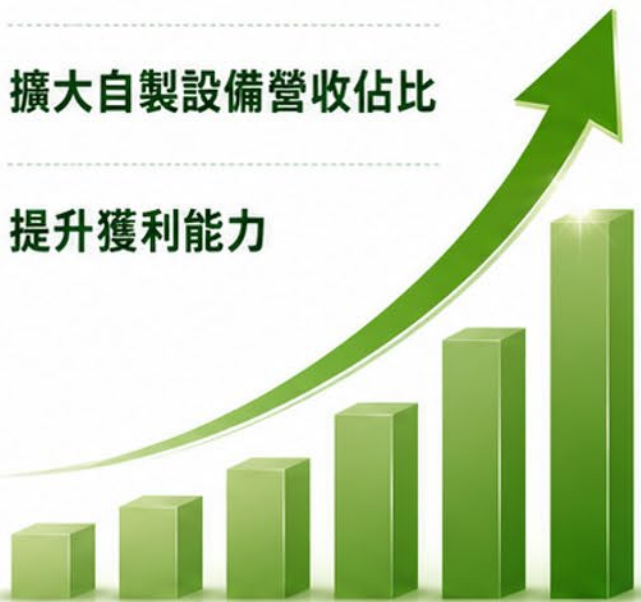
- 強化雙引擎模式
 - 代理+自製 提供更高附加價值
 - 滿足客戶深度客製化需求



- 拓展東南亞與國際半導體供應鏈,提升全球市場能見度

展望

- 自製設備營收每年成長
- 擴大自製設備營收佔比
- 提升獲利能力



財務資訊

Financial Information

Hypersonic

經營績效

Operating Results

114年經營績效重點



營業收入

13.47
億元



營業毛利

5.44
億元



毛利率

40.4%

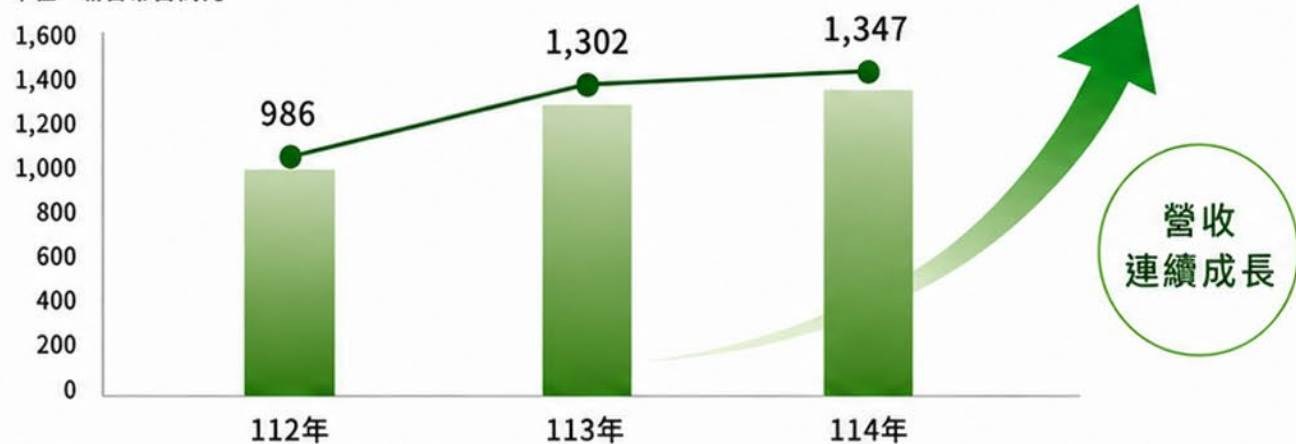


EPS

4.50
元

營業收入成長趨勢

單位：新台幣百萬元



業績的增長:115.5 YTD自結業績相較於去年同期增長18.7%



1. 營業收入：

- 113年達 13.02 億元 (年增32%)
- 114年達 13.47 億元 (年增3%)
- 連續成長創歷年新高，主力產品出貨穩定放量



2. 獲利能力：

- 113年營業毛利率 41.2%；營業利益 1.68 億元
- 114年營業毛利率 40.4%；營業利益 1.43 億元
- 整體獲利結構維持穩健



3. 每股盈餘 (EPS)：

- 113年 EPS 5.93 元 (已追溯調整)
- 114年 EPS 4.50 元
- 維持良好獲利水準



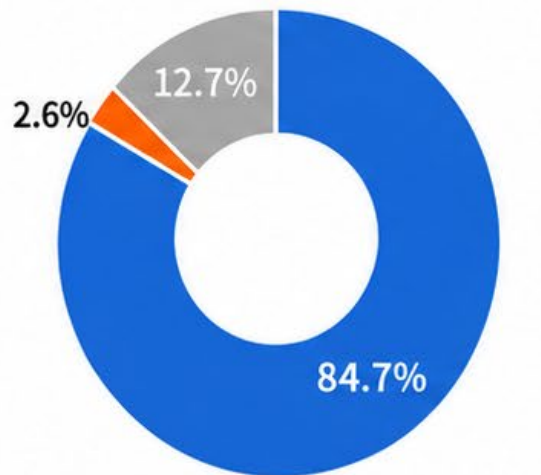
4. 營運亮點：

- 113年受惠於 AI 專案開發與半導體市場產能擴充需求成長
- 114年 AI、車用及高功率元件測試需求持續擴大
- 持續優化產品組合與營運效率，提升整體競爭力

營收比重

Revenue Mix

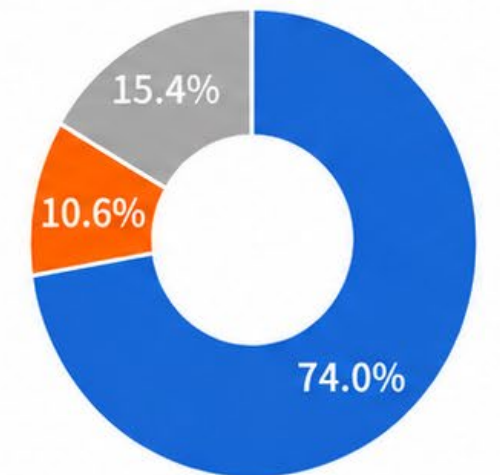
112年度



代理 自製 佣金收入與其他

合計 986 (新台幣百萬元)

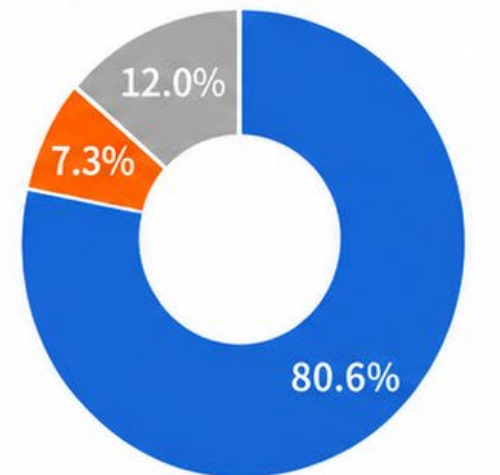
113年度



代理 自製 佣金收入與其他

合計 1,302 (新台幣百萬元)

114年度



代理 自製 佣金收入與其他

合計 1,347 (新台幣百萬元)

重點摘要

- 1 代理業務為主**
114年代理產品
占比80.6%，仍為主要
營收來源。
- 2 自製產品穩定貢獻**
114年自製產品
占比7.3%，維持穩定表現。
- 3 佣金收入與其他維持平衡**
114年占比12.0%，提供
營收結構支撐。
- 4 營收結構穩健**
代理、自製與其他收入
組合均衡，整體營收比重
維持穩健。



114年代理產品占比達80.6%，自製產品占比維持7.3%，佣金收入與其他占比12.0%，營收結構維持穩健。

財務狀況

Financial Position

114年關鍵財務指標



總資產

10.32
億元



權益總額

5.05
億元



負債比率

51.0%



速動比率

184.4%

較113年變化



總資產

+18%



負債比率

-2.5
個百分點



速動比率

+2.3
個百分點



財務結構穩健、流動性提升、營運效率維持良好



資產結構穩健

總資產持續成長，主要受流動資產增加帶動。



財務結構健康

負債比率下降，顯示資本結構維持穩健。



流動性提升

速動比率上升，短期償債能力良好。



營運效率穩定

平均收現日數 85 天、平均銷貨日數 42 天，營運效率維持穩定。

總結

Summary



獲利體質強健

- 營收連續成長創歷年新高，毛利規模維持高檔
- EPS 4.50元 | 毛利率：40.4% | 營收：13.47億元
- 速動比率達 184.4%，財務韌性佳



雙軌引擎優勢

- 優化毛利結構
- 「頂尖封裝測試設備材料代理」穩固市佔與現金流
- 「自製設備」提高滲透率，拉升高毛利表現



聚焦高成長應用市場

- 深耕先進封裝
- 全面佈局 AI、HPC 與車用電子市場



穩健股東回饋

- 共享成長果實
- 控管財務風險，保障獲利品質
- 穩定配息政策（現金與股票股利並行）
- 兼顧營運擴張與股東長期回報

Q&A

感謝各位投資人的參與